证券代码：688020 证券简称：方邦股份

**广州方邦电子股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2024-003

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动■现场参观□其他  |
| 参与单位名称及参与人姓名 | 东方财富、中信证券、海南华银天夏、瑞民投资、善一产业投资、长牛投资、冠丰私募、小松私募、圆石投资、博众投资、前海久银投资、天融资本等 |
| 时间 | 2024年9月19日 |
| 地点 | 公司展厅、会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：王作凯 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **一、对今年电磁屏蔽膜业务有何展望？贵司的电磁屏蔽产品有用于华为等终端旗舰机型上吗？**根据信通院、IDC等市场相关第三方机构发布的数据，今年上半年国内、全球手机出货情况持续回暖，叠加公司成功取得相关头部手机终端最新旗舰机型的屏蔽膜主供应商资格，我们预计公司屏蔽膜业务今年将实现较好增长。与此同时，公司密切关注新客户、新领域的技术发展趋势，如柔性屏蔽罩、折叠屏手机要求电磁屏蔽膜更薄、更耐弯折，AI手机的高算力性能引发手机内部明显的散热问题，要求电磁屏蔽膜在屏蔽功能的基础上承担部分散热功能等，持续迭代升级产品性能，以新产品、新解决方案缩短客户“等待期”，争取实现增量突破。**二、请介绍公司相关新产品的进展情况。**关于带载体可剥离超薄铜箔，从去年三季度至今，陆续通过相关载板厂及终端认证，持续获得小批量订单；预计今年下半年通过部分下游的量产认证和审厂工作，有望推动订单进一步上量；关于挠性覆铜板，坚定推进原材料自研自产战略，使用自产铜箔生产的FCCL产品在今年上半年已实现一定规模销售，产品在下游逐步铺开，产品制程数据和市场履历不断积累，预计今年下半年实现订单加快上量，争取全年实现销售量20-30万平方米，逐步成为公司业绩新增长极；使用自产铜箔+自产PI/TPI生产的FCCL，下游测试认证工作正有序开展。关于薄膜电阻，已持续实现小批量订单；下半年将进一步加快认证进度，推进通过更多下游认证，逐步实现量产突破，增厚公司业绩；同时密切关注电子产品芯片热管理的前沿需求，加大热敏型薄膜电阻的开发及下游认证工作。与此同时，公司根据相关头部消费电子终端的最新技术需求，利用自身的可剥铜、类ABF树脂材料以及合成技术，正在进行RCC、FRCC、超薄介电层FCCL等相关前沿产品的开发和下游测试认证工作。**三、请介绍此次投资江苏上达半导体有限公司的背景和目的。**公司本次投资江苏上达，是公司进一步完善和提升产业布局的举措，符合公司总体发展战略要求，对公司的业务布局和产业协同具有一定的促进作用。目标公司是国内主要的显示驱动IC覆晶薄膜封装基板（Chip On Flim，简称“COF”）供应商，2024年产能达60kk/月，主要服务颀中科技、通富微电、集创北方等国内知名IC设计公司和半导体封测公司。COF基板是显示驱动IC封装用之卷带式高密度引脚柔性封装基板，是平板显示产业链上游材料的重要一环，是生产半导体芯片所必须的关键材料之一。当前全球COF技术、产能主要集中在韩国、台湾地区，随着高清显示行业快速发展，国内COF产能自给率严重不足，国产替代的需求形成了良好市场空间。目标公司稳定量产8μm级单面COF基板，拥有核心知识产权，实现了材料、设备及药水的部分国产化，技术水平在国内处于先进水平，产品已实现产业化，具有较高的投资价值。公司与目标公司的业务具有一定的协同性。COF基板主要原材料之一为FCCL（挠性覆铜板），公司目前已布局了FCCL业务，通过加强与目标公司的交流与合作，可有效加快公司极薄FCCL研发、测试认证及产业化进程，从而提升公司经营业绩和核心竞争力。**四、公司对后续的整体业绩如何展望？**随着消费电子市场的逐步回暖以及相关产品认证工作稳步推进，我们预计屏蔽膜、可剥铜、FCCL、薄膜电阻等产品将在后续实现逐步的业绩增量；对于铜箔业务，公司将持续提升良率，并根据市场情况动态调整优化产品结构，同时将大力推进高速铜缆用屏蔽铜箔项目。通过以上举措，预计公司后续整体业绩有望逐步向好。以上预测具有不确定性，不构成投资承诺，敬请理性决策、注意投资风险。 |
| 附件清单（如有） |  |